

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

30.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年12月 1日  
Date of Application:

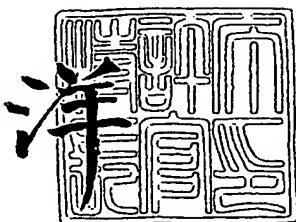
出願番号 特願2003-402110  
Application Number:  
[ST. 10/C]: [JP2003-402110]

出願人 松下電器産業株式会社  
Applicant(s):

2005年 1月 13日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

八月



【書類名】 特許願  
【整理番号】 2018051082  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H01L 21/302  
【発明者】  
【住所又は居所】 大阪府門真市松葉町2番7号 パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社内  
【氏名】 奥根 充弘  
【発明者】  
【住所又は居所】 大阪府門真市松葉町2番7号 パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社内  
【氏名】 鈴木 宏之  
【特許出願人】  
【識別番号】 000005821  
【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社  
【代理人】  
【識別番号】 100109210  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 新居 広守  
【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 049515  
【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 0213583

**【書類名】特許請求の範囲****【請求項 1】**

処理室内において Si からなる被処理体をプラズマエッチングする方法であって、  
SF<sub>6</sub>、O<sub>2</sub>及び希ガスを含むエッティングガスを前記処理室内に導入し、前記エッティング  
ガスをプラズマ化して前記被処理体をエッティングする  
ことを特徴とするプラズマエッティング方法。

**【請求項 2】**

前記希ガスは、He である  
ことを特徴とする請求項 1 に記載のプラズマエッティング方法。

**【請求項 3】**

前記処理室内に導入する He の量は、前記エッティングガスの総流量に対して 30～90  
% である

ことを特徴とする請求項 2 に記載のプラズマエッティング方法。

**【請求項 4】**

前記処理室の内壁は、絶縁性材料からなる  
ことを特徴とする請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載のプラズマエッティング方法。

**【請求項 5】**

前記絶縁性材料は、石英、アルミナ、アルマイト加工されたアルミ母材あるいは酸化イ  
ツトリウムである  
ことを特徴とする請求項 4 に記載のプラズマエッティング方法。

**【請求項 6】**

前記エッティングガスは、さらに、Cl<sub>2</sub>を含む  
ことを特徴とする請求項 1～5 のいずれか 1 項に記載のプラズマエッティング方法。

**【請求項 7】**

前記処理室内に導入する Cl<sub>2</sub>の量は、前記エッティングガスの総流量に対して 10 % 以  
下である

ことを特徴とする請求項 6 に記載のプラズマエッティング方法。

**【請求項 8】**

前記エッティングガスを ICP 法によりプラズマ化する  
ことを特徴とする請求項 1～7 のいずれか 1 項に記載のプラズマエッティング方法。

**【請求項 9】**

シリコン基板をエッティングする装置であって、  
請求項 1～8 のいずれか 1 項に記載のプラズマエッティング方法を用いて前記シリコン基  
板にトレーナーを形成する  
ことを特徴とするエッティング装置。

**【書類名】**明細書

**【発明の名称】**プラズマエッチング方法

**【技術分野】**

**【0001】**

本発明は、プラズマエッチング方法に関し、特にトレンチを良好に形成するプラズマエッチング方法に関する。

**【背景技術】**

**【0002】**

近年、エレクトロニクス機器における小型化に伴って、それに付随する半導体装置も小型化が要求されてきている。従って、半導体装置の素子分離やメモリ・セル容量面積の確保を目的としてシリコン基板に形成されるトレンチ（溝や穴）には、例えば40以上の高アスペクト比（溝または穴の深さ／溝または穴の径）が要求される。そして、このような高アスペクト比のトレンチをシリコン基板に形成する方法として、エッティングガスをプラズマ化して生じた活性種（イオンやラジカル）によりシリコン基板のエッティングを行うプラズマエッチング方法がある。

**【0003】**

ところで、トレンチには高アスペクト比が要求されると共に、図4に示されるような側壁部の傾斜角を略0度（垂直）にすることが要求される。しかし、高アスペクト比のトレンチを実現しようとする場合、トレンチの形状制御が困難となるので、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすことができないという問題がある。すなわち、プラズマエッチング方法によるシリコン基板のエッティング工程においては、電気的に中性なラジカルがシリコン基板表面に等方的に入射し、サイドエッティングを生じさせてるので、特に高アスペクト比のトレンチにおいてはこれが顕著になり、トレンチ形状が所定の形状とならず図5に示されるような形状となるのである。

**【0004】**

このような問題を解決する先行技術として、例えば特許文献1、2に記載のプラズマエッティング方法がある。

以下、特許文献1、2に記載のプラズマエッティング方法によるシリコン基板のエッティングについて図6に沿って説明する。

まず、図6（a）に示されるように、パターン形成されたマスク600を用いて、エッティングガスをプラズマ化して生じた活性種によりシリコン基板610のエッティングを行う。このとき、イオンは負バイアスにより加速されてシリコン基板610表面に垂直に入射し、垂直方向にエッティングを進行させ、ラジカルはシリコン基板610表面に等方的に入射し、上端開口部のマスク600下にサイドエッティングを生じさせる。

**【0005】**

次に、図6（b）に示されるように、エッティングに対する保護膜620を、トレンチ内のシリコン基板610表面に形成する。

次に、図6（c）に示されるように、再び活性種によりシリコン基板610のエッティングを行う。このとき、トレンチ側壁は保護膜620で覆われているため、ラジカルによる側面のエッティングは進行せず、垂直方向のエッティングと新たに現れたトレンチ側壁のエッティングが進行する。

**【0006】**

次に、図6（d）に示されるように、上記1～3の工程を繰り返す。

以上のように従来のプラズマエッティング方法によれば、エッティング工程を複数回に分けておこない、エッティングを進行させる前にはトレンチ側壁を保護膜で覆うため、エッティングの回数を増やすことで高アスペクト比のトレンチを形成することができ、トレンチ側壁のエッティングの進行を抑えることができるので、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすことができる。

**【特許文献1】**特開昭60-50923号公報

**【特許文献2】**特開平7-503815号公報

**【発明の開示】****【発明が解決しようとする課題】****【0007】**

しかしながら、従来のプラズマエッティング方法では、エッティング工程と保護膜形成の工程とが繰り返しておこなわれるために、トレンチ側壁に凸凹が生じるという問題がある。

そこで、本発明は、かかる問題点に鑑み、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすことができ、かつ、なめらかな形状の側壁を有するトレンチを形成できるプラズマエッティング方法を提供することを目的とする。

**【課題を解決するための手段】****【0008】**

上記目的を達成するために、本発明のプラズマエッティング方法は、処理室内において  $Si$  からなる被処理体をプラズマエッティングする方法であって、 $SF_6$ 、 $O_2$  及び希ガスを含むエッティングガスを前記処理室内に導入し、前記エッティングガスをプラズマ化して前記被処理体をエッティングすることを特徴とする。ここで、前記希ガスは、 $He$  であってもよいし、前記処理室内に導入する  $He$  の量は、前記エッティングガスの総流量に対して 30~90% であってもよいし、前記エッティングガスを ICP 法によりプラズマ化してもよい。

**【0009】**

これらによって、トレンチ内部のガスが外部に追い出されるようなガス流を発生させ、トレンチ内部の反応生成物及び活性種の滞在時間を短くすることができるので、高アスペクト比のトレンチを形成する場合においても、トレンチにサイドエッティングが生じたり、トレンチが先細りしたりするのを抑制することができる。つまり、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすことができるプラズマエッティング方法を実現することができる。さらに、1 回のエッティング工程によりシリコン基板にトレンチを形成することができるので、トレンチ側壁に凸凹が生じるのを防ぐ。つまり、なめらかな形状の側壁を有するトレンチを形成できるプラズマエッティング方法を実現することができる。

**【0010】**

ここで、前記処理室の内壁は、絶縁性材料からなってもよい。また、前記絶縁性材料は、石英、アルミナ、アルマイト加工されたアルミ母材あるいは酸化イットリウムであってもよい。

これによって、プラズマ密度を高く保ち、エッティングレートを高く維持し、トレンチに対する側壁保護効果が低下するのを防ぐことができるので、トレンチにサイドエッティングを生じさせず、所定形状のトレンチを形成できるプラズマエッティング方法を実現することができる。

**【0011】**

また、前記エッティングガスは、さらに、 $Cl_2$  を含んでもよい。また、前記処理室内に導入する  $Cl_2$  の量は、前記エッティングガスの総流量に対して 10% 以下であってもよい。

これによって、エッティングガスは  $Cl_2$  を含むので、トレンチ側壁保護効果が強すぎた場合に、トレンチの底まで保護する作用が働き、部分的にエッティングが阻害されて生じるトレンチの底の残渣を低減することができるプラズマエッティング方法を実現することができる。

**【発明の効果】****【0012】**

本発明に係るプラズマエッティング方法によれば、高アスペクト比のトレンチを形成する場合においても、トレンチにサイドエッティングが生じたり、トレンチが先細りしたりするのを抑制することができ、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすことができる。また、なめらかな形状の側壁を有するトレンチを形成できる。また、トレンチにサイドエッティングを生じさせず、所定形状のトレンチを形成できる。

**【0013】**

よって、本発明により、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすことができ、かつ、なめらかな形状の側壁を有するトレンチを形成できるプラズマエッチング方法を提供することが可能となり、実用的価値は極めて高い。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

##### 【0014】

以下、本発明の実施の形態におけるプラズマエッチング装置について、図面を参照しながら説明する。

図1は、本実施の形態のプラズマエッチング装置の構成を示す図である。

プラズマエッチング装置は、例えばICP (Inductively Coupled Plasma) 型エッティング装置であって、真空のエッティングチャンバー100と、エッティングチャンバー100内の上部電極110及び下部電極120と、高周波電源130a、130bと、ガス導入口140と、排気口150とを備える。

##### 【0015】

エッティングチャンバー100は、エッティングがおこなわれる処理室であり、内壁が例えば石英、アルミナ、アルマイド加工されたアルミ母材あるいは酸化イットリウム等の絶縁性材料からなる。

高周波電源130a、130bは、例えば13.57MHzの高周波電力を供給する。

ガス導入口140は、エッティングチャンバー100にガスを供給する。

##### 【0016】

排気口150は、エッティングチャンバー100内のガスを排気する。

次に、トランジスタ等の半導体装置の製造における1工程としての上記プラズマエッチング装置を用いたシリコン基板のトレンチ加工について、以下で順に説明する。

まず、下部電極120上にシリコン基板を載置し、エッティングチャンバー100内を一定の圧力に保ちながら、ガス導入口140を介してエッティングガスを供給し、排気口150から排気する。ここで、エッティングガスは、SF<sub>6</sub>ガスを主成分とし、これにO<sub>2</sub>及び希ガス、例えばHe等のガスを添加した混合ガスである。また、He量は、少ないとSF<sub>6</sub>ガス及びO<sub>2</sub>のエッティングガス中の占める割合が大きくなつてトレンチにサイドエッティングを生じたり、トレンチが先細りしたりし、また、多いとSF<sub>6</sub>ガス及びO<sub>2</sub>のエッティングガス中の占める割合が小さくなつてエッティングが進まないので、総流量に対して30～90%となるように調節する。なお、希ガスは、Ar、Xeであつてもよい。

##### 【0017】

次に、高周波電源130a、130bから上部電極110及び下部電極120にそれぞれ高周波電力を供給して、エッティングガスをプラズマ化させる。F<sup>+</sup>イオン、Fラジカル等のプラズマ中の活性種は、シリコン基板のシリコンと反応して、SiO<sub>2</sub>、Si<sub>2</sub>F<sub>6</sub>等の反応生成物を生成し、シリコン基板をエッティングしてトレンチを形成する。このとき、エッティング対象がシリコン基板であることを考慮して、下部電極120に印加するRFパワーは、低く例えれば約50Wに設定する。

##### 【0018】

以上のように本実施の形態のプラズマエッチング装置によれば、Heを含むエッティングガスを用いてシリコン基板にトレンチを形成する。よって、図2に示されるように、トレンチ内部のガスが外部に追い出されるようなガス流を発生させ、トレンチ内部の反応生成物及び活性種の滞在時間を短くすることができるので、本実施の形態のプラズマエッティング装置は、例えば40以上の高アスペクト比のトレンチを形成する場合においても、トレンチにサイドエッティングが生じたり、トレンチが先細りしたりするのを抑制することができる。つまり、トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすことができるプラズマエッティング装置を実現することができる。

##### 【0019】

また、本実施の形態のプラズマエッティング装置によれば、1回のエッティング工程によりシリコン基板にトレンチを形成する。よって、トレンチ側壁に凸凹が生じるのを防ぐことができるので、本実施の形態のプラズマエッティング装置は、なめらかな形状の側壁を有す

るトレンチを形成できるプラズマエッティング装置を実現することができる。

また、本実施の形態のプラズマエッティング装置によれば、O<sub>2</sub>を含むエッティングガスを用いてシリコン基板をエッティングする。よって、トレンチに対する側壁保護効果を高めることができるので、本実施の形態のプラズマエッティング装置は、トレンチにサイドエッチングを生じさせず、所定形状のトレンチを形成できるプラズマエッティング装置を実現することができる。

#### 【0020】

また、本実施の形態のプラズマエッティング装置によれば、エッティングチャンバー100の内壁が絶縁性材料からなる。よって、図3(a)に示されるように放電により生じた電子のエッティングチャンバー壁300への衝突によりプラズマ310の密度が低くならず、図3(b)に示されるようにプラズマ310の密度を高く保ち、エッティングレートを高く維持し、トレンチに対する側壁保護効果の低下を防止することができるので、本実施の形態のプラズマエッティング装置は、トレンチにサイドエッティングを生じさせず、所定形状のトレンチを形成できるプラズマエッティング装置を実現することができる。

#### 【0021】

なお、本実施の形態のプラズマエッティング装置において、エッティングガスは、SF<sub>6</sub>ガスを主成分とし、これにO<sub>2</sub>及び希ガスを添加した混合ガスであるとした。しかし、エッティングガスには、さらに塩素(C1<sub>2</sub>)ガスが例えば総流量の10%以下、例えば約10%添加されていてもよい。これによって、トレンチ側壁保護効果が強すぎた場合に、トレンチの底まで保護する作用が働き、部分的にエッティングが阻害されて生じるトレンチの底の残渣を低減することができる。

#### 【産業上の利用可能性】

#### 【0022】

本発明は、プラズマエッティング方法に利用でき、特に半導体装置のトレンチ加工に際しての半導体基板のエッティング等に利用することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0023】

【図1】本発明の実施の形態のプラズマエッティング装置の構成を示す図である。

【図2】同実施の形態のプラズマエッティング装置におけるエッティングガスにHeを用いた効果を説明するための図である。

【図3】同実施の形態のプラズマエッティング装置におけるエッティングチャンバー100の内壁に絶縁性材料を用いた効果を説明するための図である。

【図4】所定の形状のトレンチが形成されたシリコン基板の断面図である。

【図5】サイドエッティングの生じたトレンチが形成されたシリコン基板の断面図である。

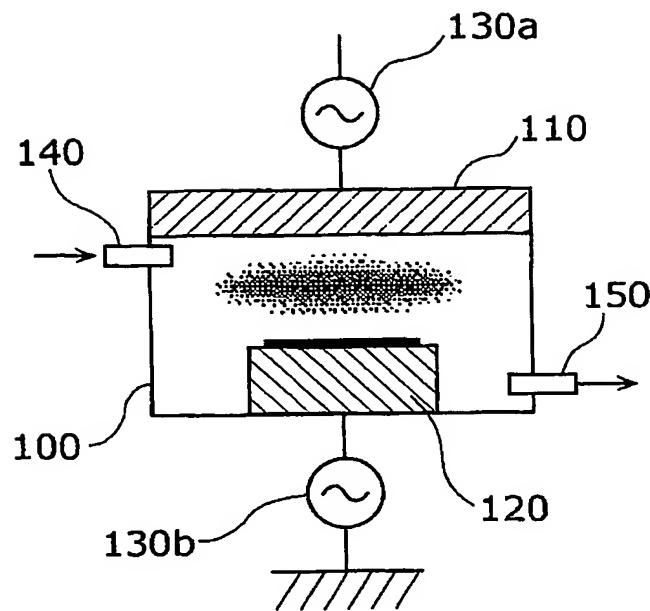
【図6】従来のプラズマエッティング方法によるシリコン基板のエッティングを説明するための図である。

#### 【符号の説明】

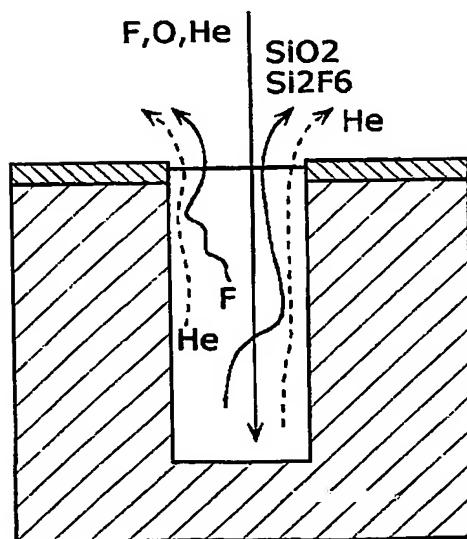
#### 【0024】

100	エッティングチャンバー
110	上部電極
120	下部電極
130a、130b	高周波電源
140	ガス導入口
150	排気口
300	エッティングチャンバー壁
310	プラズマ
600	マスク
610	シリコン基板
620	保護膜

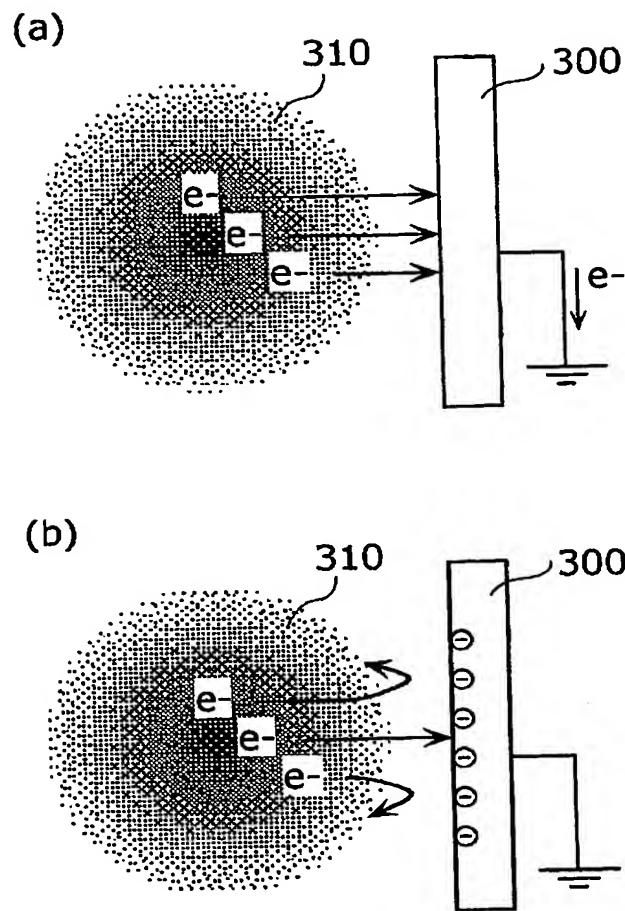
【書類名】 図面  
【図 1】



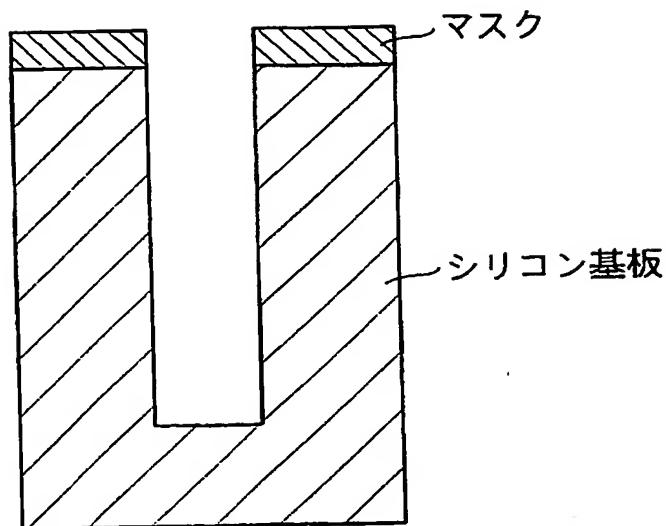
【図 2】



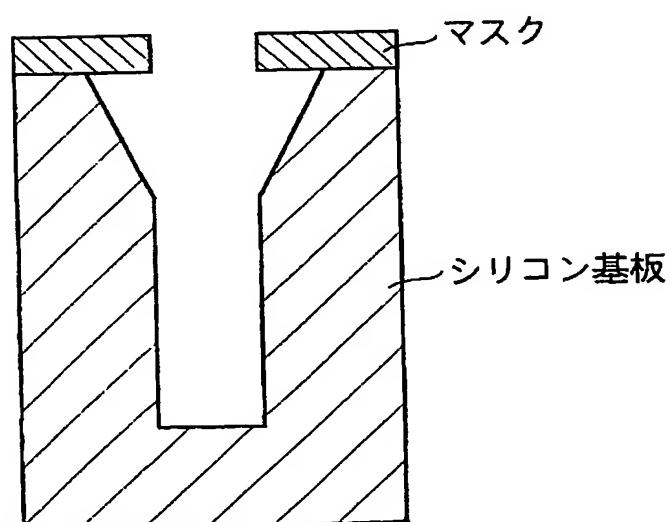
【図 3】



【図 4】

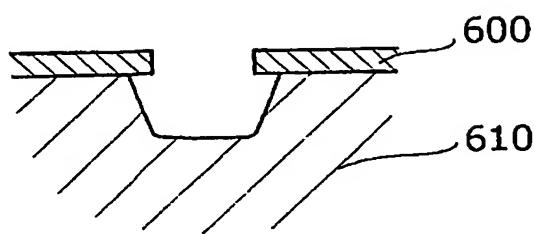


【図 5】

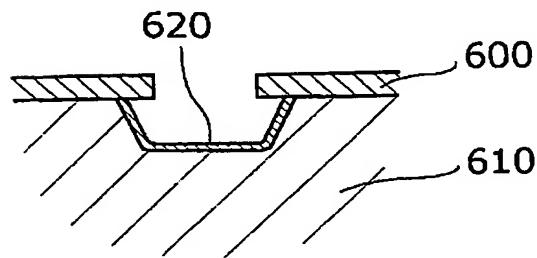


【図 6】

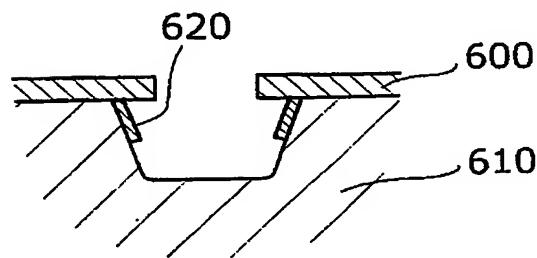
(a)



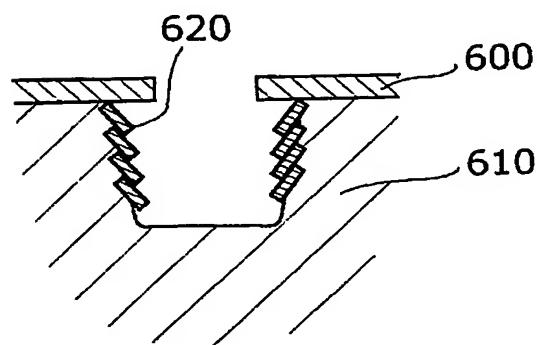
(b)



(c)



(d)



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 トレンチ形状に対する要求とアスペクト比に対する要求とを同時に満たすことができ、かつ、なめらかな形状の側壁を有するトレンチを形成できるプラズマエッティング方法を提供する。

【解決手段】 下部電極120上にシリコン基板を載置し、ガス導入口140を介してエッティングガスを供給し、排気口150から排気し、高周波電源130a、130bから上部電極110及び下部電極120にそれぞれ高周波電力を供給してエッティングガスをICP法によりプラズマ化し、活性種を生成させてシリコン基板のエッティングを進行させるプラズマエッティング方法であって、エッティングガスとしてSF<sub>6</sub>ガスを主成分とし、これにO<sub>2</sub>及びHeのガスを添加した混合ガスを用いる。

【選択図】

図2

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願2003-402110
受付番号	50301980992
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成15年12月 2日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

【提出日】 平成15年12月 1日

特願 2003-402110

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

[変更理由]

住 所

氏 名

1990年 8月28日

新規登録

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社

# **Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP04/017622

International filing date: 26 November 2004 (26.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2003-402110  
Filing date: 01 December 2003 (01.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse